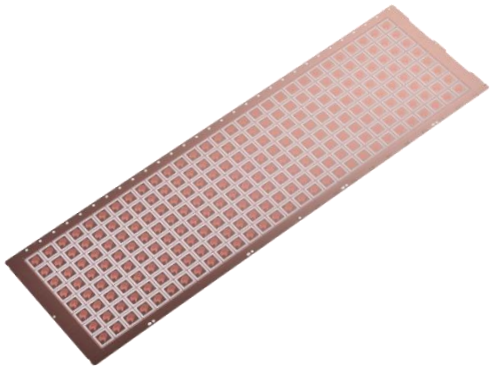
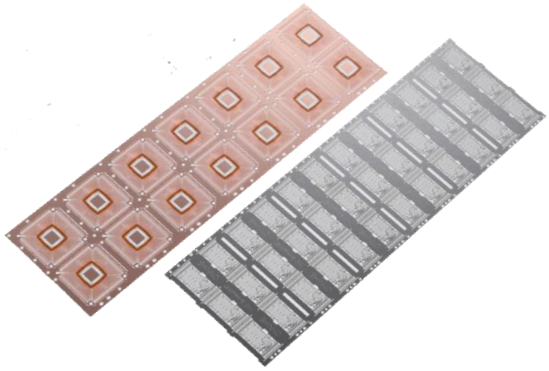
リードフレーム

概要

超精密金型によるプレス加工やエッチング加工により、さまざまなリードフレームを提供しています。



リードレスパッケージ（QFN）用リードフレーム



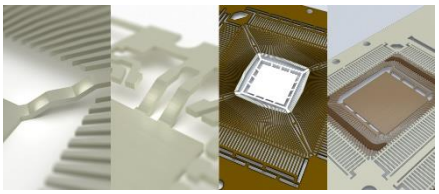
リードパッケージ(QFP/TSOP)用リードフレーム

技術

■ 露出パッド

露出パッド リードフレームは、モールドパッケージからダイパッドの裏側を露出させることにより、高い熱放散を実現するパッケージに使用されております。

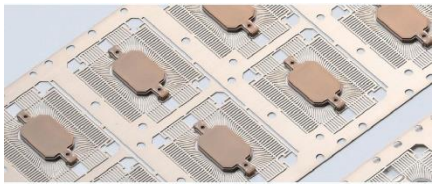
- ダイパッド端面の曲げ・ハーフカット・ハーフエッチング等のご要求に対応
- 多彩なめっきオプション：Agめっき、Pdめっき、表面粗化



露出パッド

■ かしめ

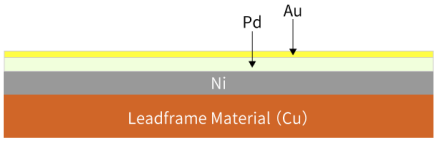
かしめリードフレームは、ダイパッドのないリードフレームと熱伝導の良い金属の放熱板を「かしめ加工」により固定した2層構造のリードフレームです。



かしめ

■ Pre-Plating（はんだレス用めっき）

はんだレスパッケージ用リードフレームは、リードフレーム全面にNi/Pd/Auの3層めっきを行うことでインナーリードとICチップ間のワイヤー接続、アウターリードとプリント基板間のはんだ接続機能を持たせ、あわせて安定したパッケージ信頼性を確保したリードフレームです。



はんだレス用めっき

新光電気工業株式会社
〒381-2287　長野県長野市小島田町80
お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。
https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.
80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN
Please contact us via inquiry form on the web.
https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php

© 2025 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.